

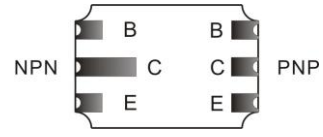
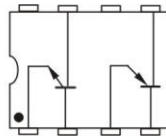
## LY100S-2 型硅 PNP/NPN 高频小功率开关晶体管对管

### 1、特性

芯片采用硅外延平面结构，器件采用 8 引脚陶瓷扁平封装和 LCC-6 型金属陶瓷封装。器件具有特征频率高、开关时间小、体积小、重量轻，可靠性高的特点。器件的静电放电敏感度为 3A 级 4000V，LCC-6 封装典型重量 0.156g。



8 引脚陶瓷扁平封装



LCC-6 型

注：LCC-6 封装产品型号后缀加“U”标识。

### 2、质量等级及执行标准

G、G+：Q/RBJ9203（8 引脚陶瓷扁平封装），Q/RBJ1026（LCC-6 型），QZJ840611。

### 3、最大额定值

器件额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

型 号		$P_{\text{tot}}^{\text{a}}$ mW	$V_{\text{CBO}}$ V	$V_{\text{CEO}}$ V	$V_{\text{EBO}}$ V	$I_{\text{CM}}$ A	$T_{\text{stg}}, T_j$ $^{\circ}\text{C}$
LY100S-2	PNP 管芯	700	-65	-60	-5	0.7	-55~150
	NPN 管芯		150	150	5		

<sup>a</sup> $P_{\text{tot}}$  是指  $T_A=25^{\circ}\text{C}$  时的最大额定功率； $T_A>25^{\circ}\text{C}$  时，按  $5.6\text{mW}/^{\circ}\text{C}$  线性地降额。

### 4、主要电特性

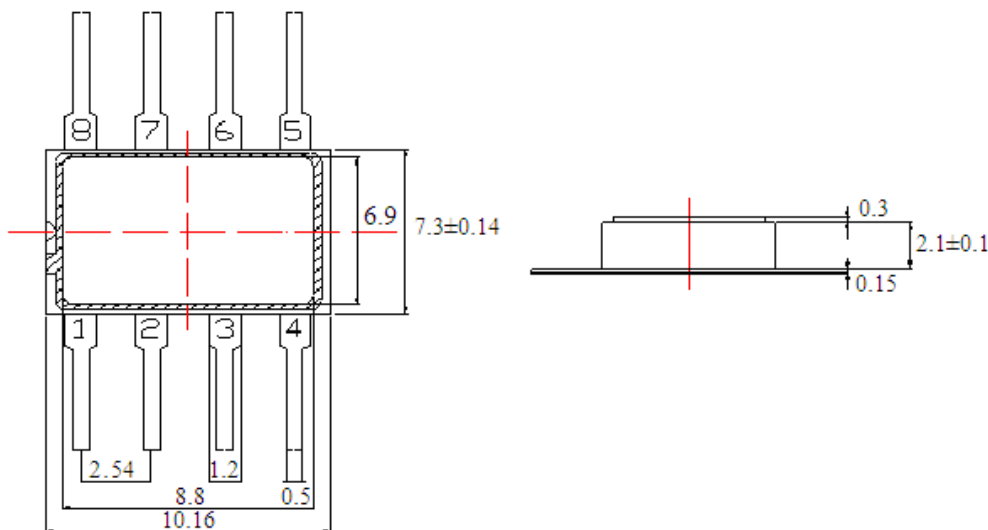
主要电特性（除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

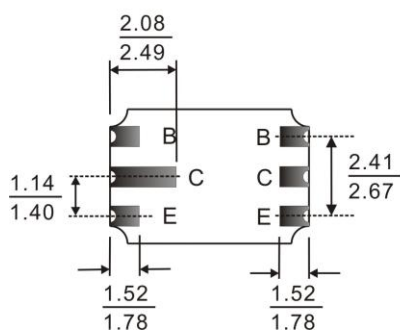
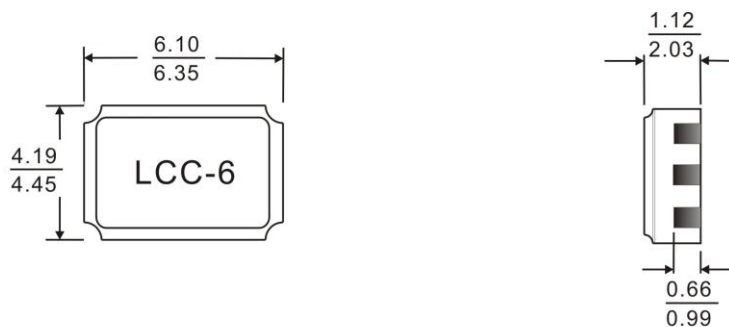
参 数		数 值			单 位
符 号	测试条件	最小值	典型值	最大值	
$V_{(\text{BR})\text{CBO}}$	$I_{\text{C}}=0.1\text{mA}$	65	—	—	V
$V_{(\text{BR})\text{CEO}}$	$I_{\text{C}}=0.1\text{mA}$	60	—	—	V
$V_{(\text{BR})\text{EBO}}$	$I_{\text{E}}=0.1\text{mA}$	5	—	—	V
$I_{\text{CBO}}$	$V_{\text{CB}}=10\text{V}$	—	0.2	0.5	$\mu\text{A}$
$I_{\text{CEO}}$	$V_{\text{CE}}=10\text{V}$	—	0.2	1	$\mu\text{A}$
$I_{\text{EBO}}$	$V_{\text{EB}}=2\text{V}$	—	0.2	1	$\mu\text{A}$
$h_{\text{FE}}$	$V_{\text{CE}}=10\text{V}, I_{\text{C}}=50\text{mA}$	40	—	150	—
$V_{\text{BE}}(\text{sat})$	$I_{\text{C}}=100\text{mA}, I_{\text{B}}=10\text{mA}$	—	0.8	1.0	V
$V_{\text{CE}}(\text{sat})$	$I_{\text{C}}=100\text{mA}, I_{\text{B}}=10\text{mA}$	—	0.2	0.5	V
$f_{\text{T}}$	$V_{\text{CE}}=10\text{V}, I_{\text{C}}=50\text{mA}, f=30\text{MHz}$	100	150	—	MHz

注：本表中参数为每个单管的电特性。

## 5、外形尺寸



8 引脚陶瓷扁平封装外形尺寸



LCC-6 外形尺寸

## 7、使用和维护

### 7.1 器件的安装

安装质量的好坏对器件的可靠性影响很大。

A3-01B 型封装，引出端直径 0.407mm~0.508mm。在安装、测试等过程中不允许多次折弯和施应力，否则易造成引脚折断或玻璃绝缘子裂缝，影响其密封性。SMD-0.2、UB 型金属陶瓷封装，在安装、测试等过程中轻拿轻放，避免碰撞、重物碾压，否则易造成陶瓷金属裂缝，影响其密封性。

焊接安装时，器件允许耐焊接热的条件是温度 260℃ 下不超过 10 秒；浸锡温度不超过 260℃，时间不超过 10 秒。

### 7.2 器件的使用

测试或筛选时应严格按照规定条件、方法进行，应使用合格的设备、仪器仪表，并对其进行校验；操作人员必须持证上岗，必要时要进行专门培训。

严禁超规范使用，注意防潮、防尘，严禁裸手直接接触器件。

测试设备、仪器仪表可靠接地。

测试过程中应采取静电防护措施。

如发生不可预期情况或误操作造成器件损坏等情况，请与供应商联系。